Документ полтисан простой алектронной полтиство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное государственное автономное образовательное учреждение** Дата подписания: 09.07.2023 20:53:26 **высшего образования** 

Уникальный про**фрациональный исследовательский технологический университет «МИСИС»** d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

## Рабочая программа дисциплины (модуля)

# Полупроводниковая наноэлектроника

Закреплена за подразделением Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет с оценкой 7

 аудиторные занятия
 51

 самостоятельная работа
 93

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого		
Недель	1	8			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	34	34	34	34	
Практические	17	17	17	17	
Итого ауд.	51	51	51	51	
Контактная работа	51	51	51	51	
Сам. работа	93	93	93	93	
Итого	144	144	144	144	

#### Программу составил(и):

к.ф.-.м.н., доцент, Рабинович Олег Игоревич

### Рабочая программа

#### Полупроводниковая наноэлектроника

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (приказ от 02.04.2015 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, 11.03.04-БЭН-22.plx , утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, , утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра технологии материалов электроники

Протокол от 21.06.2022 г., №11

Руководитель подразделения Костишин Владимир Григорьевич

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций в соответствие с учебным планом по направлению 11.04.04 в области электроники и наноэлектроники, дающих общие представления о процессах в структурах низкой размерности, современных многокомпонентных наногетерострутурах, физических процессах в них.

	2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Блок ОП: Б1.В.ДВ.06
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Материаловедение полупроводников и диэлектриков
2.1.2	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.3	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4	Технология материалов электронной техники
2.1.5	Физика диэлектриков
2.1.6	Физика конденсированного состояния
2.1.7	Безопасность жизнедеятельности
2.1.8	Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике
2.1.9	Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике
2.1.10	Статистическая физика
2.1.11	Физические свойства кристаллов
2.1.12	Электроника
2.1.13	Математическая статистика и анализ данных
2.1.14	Методы математической физики
2.1.15	Практическая кристаллография
2.1.16	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
2.1.17	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
2.1.18	Физика
2.1.19	Физическая химия
2.1.20	Электротехника
2.1.21	Математика
2.1.22	Органическая химия
2.1.23	Информатика
2.1.24	химих
2.1.25	Инженерная и компьютерная графика
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Вакуумная и плазменная электроника
2.2.2	Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике
2.2.3	Магнитные измерения
2.2.4	Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики
2.2.5	Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники
2.2.6	Нормы и правила оформления ВКР
2.2.7	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики
2.2.8	Основы радиационной стойкости изделий электронной техники
2.2.9	Основы технологии электронной компонентной базы
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.11	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.12	Приборы квантовой и оптической электроники
2.2.13	Процессы вакуумной и плазменной электроники
2.2.14	Светоизлучающие полупроводниковые приборы
2.2.15	Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики
2.2.16	Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом
2.2.17	Элементы и устройства магнитоэлектроники

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-5: Способность разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий электронной техники

Знать:

ПК-5-31 изделия электронной техники

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, соответствующие профилю подготовки, разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

Знать:

ОПК-4-31 принципы работы современных информационных технологий

УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения

Знать:

УК-2-31 Физическую сущность процессов, протекающих при реализации нанотехнологий.

ПК-5: Способность разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий электронной техники

#### Уметь:

ПК-5-У1 разрабатывать технические описания

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, соответствующие профилю подготовки, разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

Уметь:

ОПК-4-У1 использовать современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности

УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения

Уметь:

УК-2-У1 Различать физические свойства электронных системах различной размерности.

ПК-5: Способность разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий электронной техники

#### Владеть:

ПК-5-В1 создавать описания изделий электронной техники

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, соответствующие профилю подготовки, разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

Владеть:

ОПК-4-В1 разработкой алгоритмами и компьютерными программами, пригодными для практического применения

УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения

### Владеть:

УК-2-В1 Методами выбора материала и необходимой технологии его изготовления при конструировании конкретного типа прибора с заданными характеристиками.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ								
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполн яемые работы	
	Раздел 1. Классификация наноразмерных структур								

1.1	Фундаментальные сведения о полупроводниковых наноразмерных структурах. Сравнительный анализ перспектив Si, Ge, соединений A3B5, A2B6, A4B4. Наногетероструктуры и наиболее распространенные системы полупроводниковых материалов на основе твердых растворов A3B5. Обзор физических свойств объёмных трёхмерных (3D) полупроводников. /Лек/	7	10	УК-2-31 УК-2- У1	Л1.1 Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э3	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.		
1.2	Анализ свойств объёмных трёхмерных (3D) полупроводников — зонные энергетические диаграммы электронов, плотности состояний, легирование, статистика носителей заряда /Пр/	7	4	ПК-5-31 ПК-5- У1 ПК-5-В1	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л3.3Л3.2 Л3.5 Э2	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.		
1.3	Подготовка к написанию контрольной работы №1 /Ср/	7	5	УК-2-У1	Л1.3 Л1.1Л3.3Л3. 5 Э1	Методически е указания по решения задач на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		
1.4	Написание контрольной работы №1 /Пр/	7	1	УК-2-31	Л1.3 Л1.1Л3.5Л3. 2 Э1	Методически е указания по решения задач на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)	KM2	
1.5	Проработка лекционного материала для практических занятий /Ср/	7	7	ОПК-4-31 ОПК-4-У1 ОПК-4-В1	Л1.2 Л1.1Л2.3 Л2.1Л3.5 ЭЗ	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		
	Раздел 2. Технологии получения низкоразмерных структур Моделирование свойств и физических процессов в многослойных гетероструктур.							
2.1	Низкоразмерные структуры и их свойства. /Лек/	7	11	ОПК-4-В1	Л1.3 Л1.1Л3.3 Л3.5Л3.4 Э1	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.		

2.2   Проработна деспроизвот   7   10   ПК-5-31   Л.П.З. 2012   3   1   1   1   1   1   1   1   1   1	2.3 По раз 2.4 На раз 1.5 Со по по пл на 2.6 М.		7	10	ПК-5-31	Л1.1Л3.2Л2. 3	е указания		
2.3   Подготовка к контрольной работе /Ср/   14   УК-2-У1   Л1.3   Л1.1/13.51/3   2.1/3.3   31.33   31.33   31.33   31.33   31.34   31.35   31.34   31.35   31.34   31.35   31.35   31.34   31.35	2.4 Ha pa					1			
2.3   Подготовка к контрольной работе /Ср/   7   14   УК-2-УІ   Л.1.	2.4 Ha pa					Э1			
2.3   Подготовка к контрольной работе /Ср/   7   14   УК-2-У1   Л1.3   2.13.3   2.13.3   3.13.5   3	2.4 Ha pa								
2.3   Подготовка к контрольной работе /Ср/   14   УК-2-УІ   Л.1.3   Методически с раждания в мафедре   19   11.113.513.   1.3.3   1	2.4 Ha pa								
2.3   Подготовкая к контрольной работе /Ср/   14   УК-2-УІ   ЛІЗ   ЛІЗ-ЗІЗ-ЗІЗ   е учежавия по решения задач на задач	2.4 Ha pa						` * •		
работе /Ср/    11.113.513. 2   21.33   31.38   21.33   31.38	2.4 Ha pa						кафедре)		
2.13.3   порещения задач на задектронном и бумажном носителе (присутству кот на кафедре)   поработы №2 /Пр/   1.13.3   1.11.13.4112.   поработы №2 /Пр/   1.13.3   1.11.13.4112.   поработы №2 /Пр/   1.13.3	2.4 На ра ра по по по пл на 2.6 М.		7	14	УК-2-У1				
2.4   Написание контрольной работы №2 /Пр/   7   4   ОПК-4-У1   Л1.3   Л1.Л13.4/12   Указания но решения зафедре)   1   Методически км3	2.5 Ссопо по пл на 2.6 М.	боте /Ср/					1 -		
2.4   Написание контрольной работы №2 /Пр/   7   4   ОПК-4-У1   Л1.3   Методически км3 е указания по решения задам на электронном носителе (присутству ют на кафедре)   2.5   Современные технологии получения породятся в намогетероструктур. /Лек/   3   Л1.3   Завятия проводятся в проводятся в проводятся в получения получени	2.5 Ссопо по пл на 2.6 М.						-		
10   10   10   10   10   10   10   10	2.5 Ссопо по пл на 2.6 М.								
2.4   Написание контрольной работы №2 /Пр/   7   4   ОПК-4-УІ   ЛІ.3   Методически км3   кмфсаре)   7   4   ОПК-4-УІ   ЛІ.3   Методически км3   1.1Л3.4/12.   2.5   Км3 ана на электронном и бумажном посителе (присутству кот на кафсаре)   7   2   ПК-5-ВІ   ЛІ.3   Завятия полутроводниковых тонких пленок и нанотетероструктур. /Пек/   3   ЛІ.1Л3.2   ЛІ.1Л3.2   ЛІ.1Л3.3   Завятия полутроводниковых тонких пленок и нанотетероструктур. /Пек/   3   ЛІ.1Л3.2   ЛІ.1Л3.3   Завятия пой ТСО.   7   3   ПК-5-ЗІ   ЛІ.3   Завятия проводятся в аудитории, оборудовани ой ТСО.   7   2   М.Т. Отгольектронные приборы на основе нано-лектронные приборы на основе нано-лектронные приборы на основе нано-лектронные приборы пано-лектронные приборы пано-лектронные приборы на основе нано-лектронные приборы на основе на основение на основе на основе на основе на основе на основе на основе	2.5 Ссопо по пл на 2.6 М.								
2.4   Написание контрольной работы №2 /Пр/   7   4   ОПК-4-У1   Л1.3   Л1.Л3.4П2.   9 указания   Методически е указания   31   3   3   3   3   3   3   3   3	2.5 Ссопо по пл на 2.6 М.								
2.4   Написание контрольной работы №2 /Пр/   3   3   311.13.3   11.13.412.   3   3   31.13.3   3   31.13.3   3   3   3   3   3   3   3   3   3	2.5 Ссопо по пл на 2.6 М.						` * *		
работы №2 /Пр/  ——————————————————————————————————	2.5 Ссопо по пл на 2.6 М.						кафедре)		
3	2.5 Сс по по пл на 2.6 М.		7	4	ОПК-4-У1			КМ3	
2.5   Современные технологии получения информациона и доступрация и д	по по пл на 2.6 М.	юоты №2 /Пр/							
2.5   Современные технологии получения полу	по по пл на 2.6 М.						_		
2.5   Современные технологии   7   2   ПК-5-В1   Л1.3   Л1.1Л3.2   Получения   Получения   Л3.5   ПП. Л3.3   Подготовка и выполнение   7   2   ПК-5-В1   Л1.3   Л1.1Л3.2   ПП. Л3.3   ДП. Л3.5   ДП.	по по пл на 2.6 М.						электронном		
2.5   Современные технологии получения полупроводниковых тонких пленок и наногетероструктур. /Лек/   3   ПК-5-В1   Л1.3   проводятся в полупроводниковых тонких пленок и наногетероструктур. /Лек/   3   ПК-5-31   Л1.3   Занятия проводятся в полупроводятся в по	по по пл на 2.6 М.						1 * 1		
2.5   Современные технологии   7   2   ПК-5-В1   Л1.3   Занятия   получения   получения   Пполучения   Ппо	по по пл на 2.6 М.								
2.5   Современные технологии получения получения получения получения получения получения получения пленок и пленок и наногетероструктур. /Лек/   3   11.13.2   33.13.4   37.1.13.2   37.1.13.3   37.1.13.3   37.1.13.2   37.1.13.3   37	по по пл на 2.6 М.								
Получения   Пол	по по пл на 2.6 М.						кафедре)		
Полупроводниковых тонких пленок и наногетероструктур. /Лек/   31.3.313.4   3.3.13.5   3.3.13.4   3.3.13.5   3.3.13.4   3.3.13.5   3.3.13.4   3.3.13.5	по пл на 2.6 М.	-	7	2	ПК-5-В1				
Пленок и наногетероструктур. /Лек/   3   ПК-5-31   Л1.3   Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.	пл на 2.6 М.								
Ваногетероструктур. /Лек/   3	2.6 M.								
Технология /Пр/		ногетероструктур. /Лек/							
Падатическим авыполнение домашнего задания - /Ср/   Падатически домашнего задания - /Ср/   Падатически доборидован об тосо.   Падатически домашнего задания - /Ср/   Падатически домашнего задания - /Ср/   Падатически доборидовани об тосо.   Падатически домашнего задания - /Ср/   Падатичес	TO		7	3	ПК-5-31				
Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/   Подготовки к данатов доборудован дой тосо.   Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/   Дл. 3 данятия данатия для подготовки к дл. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	16.	хнология /Пр/							
31									
наногетероструктур и свойства приборов наноэлектроники         7         8         УК-2-31         Л1.3         Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.           3.2         Проработка лекционного материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/         7         12         УК-2-У1         Л1.3 Методически е указания на занятиям на кафедре)           3.3         Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/         7         20         ОПК-4-У1         Л1.3 Методически е указания           3.3         Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/         7         20         ОПК-4-У1         Л1.3 Методически е указания									
свойства приборов наноэлектроники         7         8         УК-2-31         Л1.3         Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.           3.2         Проработка лекционного материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/         7         12         УК-2-У1         Л1.3         Методически е указания на электронном носителе (присутству ют на кафедре)           3.3         Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/         7         20         ОПК-4-У1         Л1.3         Методически детодически е указания           3.3         Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/         7         20         ОПК-4-У1         Л1.3         Методически е указания	I I								
Наноэлектроннки   3.1   Оптоэлектронные приборы на основе наногетероструктур /Лек/   8   УК-2-31   Л1.3   Л1.3   Проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.   3.2   Проработка лекционного материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/   12   УК-2-У1   Л1.3   Методически л1.1Л2.1Л3.   е указания на занятиям /Ср/   33   Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/   7   20   ОПК-4-У1   Л1.3   Методически дл1.1Л2.1Л3.   е указания									
3.1         Оптоэлектронные приборы на основе наногетероструктур /Лек/         7         8         УК-2-31         Л1.3         Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.           3.2         Проработка лекционного материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/         7         12         УК-2-У1         Л1.3         Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)           3.3         Подготовка и выполнение домашнего задания- /Ср/         7         20         ОПК-4-У1         Л1.3         Методически е указания									
на основе наногетероструктур /Лек/  3.2 Проработка лекционного материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/  3.3 Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/  10 ОПК-4-У1 Л1.3 проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.  3.4 Проработка лекционного дагания на обружать и бумазания на электронном носителе (присутству ют на кафедре)  3.5 Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/  3.6 Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/  3.7 Подготовка и выполнение домашнего задания на на кафедре)	I I	-	7	8	УК-2-31	Л1.3	Занятия		
3.2   Проработка лекционного материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/   3.3   Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/   3.4   20   ОПК-4-У1   Л1.3   Методически е указания на электронном носителе (присутству ют на кафедре)   3.3   Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/   7   20   ОПК-4-У1   Л1.3   Методически е указания   20   ОПК-4-У1   Л1.3   ОПТО   20   ОПК-4-У1   Л1.3   ОПТО   20   ОПК-4-У1   Л1.3   ОПТО   20   ОПТО   2	на	основе				Л1.1Л3.2Л3.	проводятся в		
3.2   Проработка лекционного материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/   3.3   Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/   7   12   УК-2-У1   Л1.3   Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)   3.3   Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/   7   20   ОПК-4-У1   Л1.3   Методически е указания   Методически е указания   Л1.1Л2.1Л3.   Подготовка и выполнение домашнего задания   7   20   ОПК-4-У1   Л1.3   Методически е указания   Л1.1Л2.1Л3.   Подготовка и выполнение домашнего задания   Л1.1Л2.1Л3.   Подготовка и выполнени	на	ногетероструктур /Лек/							
3.2       Проработка лекционного материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/       7       12       УК-2-У1       Л1.3 Д.1Л3. В для подготовки к практическим ванятиям /Ср/       93       Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)         3.3       Подготовка и выполнение домашнего задания / Cp/       7       20       ОПК-4-У1       Л1.3 Методически е указания						91 33			
материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/ ЭЗ и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)  3.3 Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/ Домашнего за	3.2 Пг	роработка лекционного	7	12	УК-2-У1	Л1.3			
Занятиям /Ср/   ЭЗ и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)   3.3 Подготовка и выполнение домашнего задания - /Ср/   7 20 ОПК-4-У1 Л1.3 Методически е указания   20 Казания   20 К	ма	атериала для подготовки к				Л1.1Л2.1Л3.	е указания на		
3.3 Подготовка и выполнение домашнего задания   7   20   ОПК-4-У1   Л1.3   Методически е указания   20   П.1.Л2.1.Л3.   Суказания   1.1.Л2.1.Л3.   1.1.Л2.1.Л3.   2.1.Л3.   2.1.Л3.   3.1.Л3.   3									
3.3 Подготовка и выполнение домашнего задания - /Cp/   7   20   ОПК-4-У1   Л1.3   Методически е указания   е указания   1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	321	нятиям /Ср/				95			
3.3 Подготовка и выполнение домашнего задания - /Cp/ 7 20 ОПК-4-У1 Л1.3 Методически домашнего задания с указания									
3.3         Подготовка и выполнение домашнего задания - /Cp/         7         20         ОПК-4-У1         Л1.3         Методически е указания							ют на		
домашнего задания- /Ср/ Л1.1Л2.1Л3. е указания	22 5			20	OHIC 4 374	П1.2			
	I I		7	20	ОПК-4-У1				
		лашного задания /Ср/				1			
Э1 Э3 электронном						<b>Э1 Э3</b>	электронном		
и бумажном							1 * 1		
носителе (присутству									
ют на									
				1		I	кафедре)		

2.4				XIIC 2 XII	пт эпээ	l n		
3.4	Силовые приборы на	7	3	УК-2-У1	Л1.3Л3.2	Занятия		
	основе				Л1.1Л3.3 Л3.5	проводятся в		
	наногетероструктур /Лек/					аудитории,		
					91 93	оборудованн		
						ой ТСО.		
3.5	Проработка лекционного	7	10	УК-2-В1	Л1.3	Методически		
	материала для				Л1.1Л2.1	е указания на		
	практических работ /Ср/				Л3.4Л3.3	электронном		
					Л3.5	и бумажном		
					Э2	носителе		
						(присутству		
						ют на		
						кафедре)		
3.6	Защита домашнего	7	4	ПК-5-У1	Л1.2	Занятия		P1
	задания /Пр/				Л1.1Л2.1Л3.	проводятся в		
					2 Л3.5	аудитории,		
					<b>Э1 Э3</b>	оборудованн		
						ой ТСО.		
						Проверка в		
						системе LMS		
						CANVAS.		
3.7	Подготовка к контрольной	7	15	ПК-5-У1	Л1.2	Методически		
	работе /Ср/				Л1.1Л2.1Л3.	е указания		
					5	на		
					Э3	электронном		
						и бумажном		
						носителе		
						(присутству		
						ют на		
						кафедре		
3.8	Выполнение контрольной	7	1	ПК-5-31	Л1.3	Методически	KM4	
	работы 3 /Пр/				Л1.1Л2.1Л2.	е указания		
					3	по решения		
					Э3	задач на		
						электронном		
						и бумажном		
						носителе		
						(присутству		
						ют на		
						кафедре		

5.	1. Контрольные меро	приятия (контрольная	ОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для тельной подготовки
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки

L/M1	Роиот а ополист	VIC 2 21.000 /	1
KM1	Зачет с оценкой	УК-2-31;ОПК-4- 31;ОПК-4-У1;ОПК-	1. Классические и квантово-размерные явления/эффекты
		4-B1;YK-2-Y1;YK-2	Классические и квантово-размерные явления/эффекты     Условия наблюдения и суть квантово-размерных эффектов
		-В1;ПК-5-31;ПК-5-	3. Квантово-размерный ямы, их классификация и особенности
		В1;ПК-5-У1	4.Электроны в бескрайних и ограниченных квантово-размерных
		B1,1111 5 7 1	ямах
			5. Размерное квантование в потенциальных ямах
			6. Электронные состояние в кванто-размерных ямах
			7. Множественные квантово-размерные ямы и сверхрешетки
			8. Влияние электрического поля на эффекты в одиночной квантово
			-размерной яме
			9. Влияние электрического поля на эффекты в множественных
			квантово-размерных ямах. Эффект туннелирования
			10. Структуры с 2D электронным газом
			11. 1D, 0D мерные системы-примеры и особенности
			12. Особенности гетероструктур
			<ul><li>13. δ-легирование слоев гетероструктур</li><li>14. Дефекты в гетероструктурах и их влияние на свойства</li></ul>
			материалов
			15. Энергетические состояния в сверхрешетках
			16. Влияние примеси на энергетические состояния в
			гетероструктурах, в квантово-размерных ямах
			17 Нанолитография
			18 Методы выращивания многокомпонентных наногетероструктур
			19 Светоизлучающие диоды
			20 Виды транзисторов и их основные особенности
			1. Получить оценку предельной толщины пленки, при которой
			возможно наблюдение
			квантово-размерных явлений, если подвижность электронов в пленке 104 см2 /(В с).
			2. Какова предельная толщина пленки, при которой возможно
			наблюдение квантово-
			размерных явлений при комнатной температуре, если эффективная
			масса носителей $m = 0,1m0$ ?
			3. Для прямоугольной квантовой ямы шириной L и глубиной U
			получить уравнение для определения значений энергии связанных
			состояний. Определить число связанных состояний в яме. Найти
			условие, при котором расстояние по шкале энергий от вершины
			барьера до нижнего уровня в яме равно заданной величине ЕО.
			4. Поверхность тонкой монокристаллической пленки кремния имеет ориентацию (100). Рассчитайте плотность электронных
			состояний в таком двумерном электронном газе. Что изменится при
			ориентации поверхности (111)?
			5. Рассчитать длину волны в максимуме спектра излучения между
			первыми связанными состояниями электронов и дырок в квантовой
			яме твёрдого раствора In0,1Ga0,9N шириной 2 нм и бесконечной
			глубиной. Эффективная масса электронов mn= 0,2m0, эффективная
			масса дырок mp= 1,5m0.
			6. Найти связь между концентрацией электронов и уровнем Ферми
			для вырожденного одномерного электронного газа.
			7. Определить ток, при котором происходит полное заполнение
			носителями заряда активной области двойной гетероструктуры AlGaAs/GaAs. Высота потенциального барьера ΔΕС=0,2 эВ.
			Папаального оарьера дес=0,2 эв. Ширина активной области равна 50 нм.
			8. Энергия ионизации магния (Mg) в GaN Ea= 200 мэВ. Какая
			часть акцепторов будет ионизирована при температуре 300 К, если
			их концентрация равна 1018 см-3?
			9. Определить два основных условия при которых баллистическая
			проводимость квантовой проволоки описывается формулой σ =e2/
			$\pi\hbar$
			10. Определить минимальный диаметр сферической квантовой
			точки в системе GaAs- Al0,4Ga0,6As при котором существует один
			электронный уровень. использовать такие параметры как разрыв в
			зоне проводимости ΔЕС=0,3 эВ, эффективную массу электронов mn= 0,1m0
			IIII

KM2	Контрольная	УК-2-31	1. GaN: это материал AIIBVI или AIIIBV?
	работа 1		2. GaAs, InN, AIP, Si: какой из представленных материалов
			является прямозонным ?
			3. Ответьте как изменится энергетическая запрещённая зоны с
			увеличением X (содержанием элемента)?
			4. В какой структуре наилучшее согласование между слоями AlAs-GaAs and GaP-InP?
			5. Плёнки GaN films выращены МОС-гидридной технологией:
			какие наиболее используемые источники.?
			6. Токи какой природы не протекают в квантово-размерных ямах
			двойной гетероструктуры: дрейфово-дифффузионной,
			теромоэлектронной или туннелирования?
			7. Какой вид подложки для гетероструктур AlGaInN, выращенных
			МОС-гидридной технологий
КМ3	Контрольная работа 2	ОПК-4-У1	8. Получить оценку предельной толщины пленки, при которой возможно наблюдение
	Factoria		квантово-размерных явлений, если подвижность электронов в пленке 104 см2 /(В с).
			9. Какова предельная толщина пленки, при которой возможно наблюдение квантово-
			размерных явлений при комнатной температуре, если эффективная
			масса носителей m = 0.1m0? 10. Для прямоугольной квантовой ямы шириной L и глубиной U
			получить уравнение для
			определения значений энергии связанных состояний. Определить
			число связанных
			состояний в яме. Найти условие, при котором расстояние по шкале
			энергий от вершины
			барьера до нижнего уровня в яме равно заданной величине Е0.
			11. Поверхность тонкой монокристаллической пленки кремния
			имеет ориентацию (100).
			Рассчитайте плотность электронных состояний в таком двумерном
			электронном газе. Что
			изменится при ориентации поверхности (111)?
KM4	Контрольная	ПК-5-31	12. Гетероструктуры в системе AlInGaN могут быть полярными
	работа 3	1111 2 31	или нет, Какие структуры выращенные на подложке Al2O3 в
	Passias		направлении -с?
			13. Что обозначает MOSFET - ?
			14. Что означает НЕМТ - ?
			15. Рассчитать длину волны в максимуме спектра излучения между
			первыми связанными состояниями электронов и дырок в квантовой
			яме твёрдого раствора In0.1Ga0.9N шириной 2 нм и бесконечной
			глубиной. Эффективная масса электронов mn= 0.2m0, эффективная
			масса дырок mp= 1.5m0.
			16. Найти связь между концентрацией электронов и уровнем
			Ферми для вырожденного
			одномерного электронного газа.
			17. Определить ток, при котором происходит полное заполнение
			носителями заряда активной области двойной гетероструктуры
			АlGaAs/GaAs. Высота потенциального барьера ΔΕС=0.2эВ.
			Ширина активной области равна 50нм.
<b>5.2.</b> Пеп	ечень работ, выпол	—— няемых по дисциплине	е (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)
Код	Название	Проверяемые	
работы	работы	индикаторы	Содержание работы
T _	1 1	компетенций	1

P1	Домашнее задание	ПК-5-У1	1. Размерное квантование. Двумерные (2D) системы – квантово-
			размерные ям в двойных гетероструктурах на основе соединений
			AlGaInN
			2. Соединения AIIIBV и традиционные материалы Si/Ge –
			различия основных характеристик
			3. Одномерные (1D) системы –квантовые точки (КТ). Спектр и
			плотность электронных состояний, статистика и транспорт
			носителей заряда.
			4. Особенности транспорта носителей заряда в 3D, 2D, 1D и 0D
			системах
			5. Баллистический транспорт и проводимость в квантовых
			проволоках (КП).
			6. Метод молекулярно лучевой эпитаксии и МОС-гидридная
			технология получения соединений AIIIBV – преимущества и
			недостатки.
			7. Основные методы и инструментарий для исследований
			структурных свойств наноразмерных материалов: атомно-силовая
			микроскопия, сканирующее – туннельная микроскопия, Оже-
			микроскопия, рентгеновская микроскопия
			8. Экситоны в одномерных (1D) квантовые проволоки (КП) и
			нульмерных (0D) –квантовые точки (КТ) системах.
			9. Самоорганизующие системы в соединениях AIIIBV.
			10. Основы и инструментарий нанолитографии
			11.Полевые транзисторы с двумерным газом (2D) на основе Si
			MOSFET и на гетероструктурах AlGaAs/GaAs с высокой мобильностью электронов в канале (HEMT): сравнение их
			характеристик.
			ларактеристик. 12. AlGaInN – Светоизлучающие диоды.
			13. Роль квантово-размерных ям в оптическом свечении
			излучающих диодов
			14. Гетеролазеры с КЯ и КТ на основе соединений AIIIBV.
			15. Пьезоэлектрическое поле, спонтанная поляризация, эффект
			поляризации и Штарка.
			16. Одноэлектронный компьютер – физические основы и
			перспективы.
	5.3. Оценочные м	иатериалы, использу	емые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

В данном курсе предусмотрен Зачет, как финальное испытание.

Билет состоит из 2-х вопросов.

Вопросы для оценки располагаются в разделе для самоподготовки.

Первый вопрос - теоретический и типовые варианты представлены в разделе для самоподготовки.

Второй вопрос - расчетно-графический и типовые варианты представлены в разделе для самоподготовки.

Вариант билета прикреплен в разделе Приложения.

#### 5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

По дисциплине для получения Зачета студент должен полностью выполнить учебный план: написать все контрольные работы, выполнить и защитить ДЗ.

Оценки за контрольную работу выставляются по следующим критериям:

- а) «отлично» студент правильно решил задачи и полно ответил на все теоретические вопросы;
- б) «хорошо» студент решил задачи и недостаточно полно ответил на все теоретические вопросы;
- в) «удовлетворительно» студент неправильно решил задачи, неполно ответил на теоретические вопросы;
- г) «неудовлетворительно» студент не решил задачу, не ответил на теоретические вопросы.

Защита ДЗ происходит в электронной среде Canvas. Оценка выставляется по следующим критериям:

- а) «отлично» студент правильно провел анализ информации, полно представил работу, сделал правильные выводы, исчерпывающе ответил на вопросы при защите работы;
- б) «хорошо» –студент правильно или с небольшими ошибками представил информацию, сделал правильные выводы, недостаточно полно ответил на вопросы при защите работы;;
- в) «удовлетворительно» студент провел необходимые расчеты с незначительными ошибками, представил неверный анализ, сделал неполные или неправильные выводы, недостаточно полно ответил на вопросы при защите работы;
- г) «неудовлетворительно» студент провел представил анализ с грубыми ошибками, сделал неправильные выводы, не ответил или ответил неверно на вопросы при защите работы;.

Оценка за Зачет формируется как среднеарифметическое за все контрольные работы и ДЗ

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## 6.1. Рекомендуемая литература

			ная литература	
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Павлов Л. П.	Методы определения основных параметров полупроводниковых материалов: учеб. пособие для студ. вузов спец. 'Полупроводниковые приборы'	Библиотека МИСиС	М.: Высш. шк., 1975
Л1.2	Шалимова К. В.	Физика полупроводников: учебник для вузов по спец. 'Полупроводниковые и микроэлектрон. приборы'	Библиотека МИСиС	М.: Энергия, 1976
Л1.3	Шалимова К. В.	Физика полупроводников: учебник для вузов по спец. 'Полупроводниковые и микроэлектрон. приборы'	Библиотека МИСиС	М.: Энергия, 1971
		6.1.2. Дополнит	ельная литература	
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Ковалев А. Н.	Транзисторы на основе полупроводниковых гетероструктур: монография	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2011
Л2.2	Ковалев А. Н., Рабинович О. И., Тимошина М. И.	Физика и технология наноструктурных гетерокомпозиций: учебник	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2015
		6.1.3. Методич	еские разработки	·
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Зи С. М., Трутко А. Ф.	Физика полупроводниковых приборов: пер. с англ.	Библиотека МИСиС	М.: Энергия, 1973
Л3.2	Рабинович О. И., Крутогин Д. Г., Евсеев В. А.	Основы технологии электронной компонентной базы. Моделирование технологических процессов получения тонкопленочных материалов: учебно-метод. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2012
Л3.3	Сушков В. П., Кузнецов Г. Д., Рабинович О. И.	Конструирование компонентов и элементов микро- и наноэлектроники. Компьютерное моделирование оптоэлектронных приборов: учебно-метод. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2012
Л3.4	Рабинович О. И., Крутогин Д. Г.	Основы технологии электронной компонентной базы. Методы контроля характеристик материалов в технологических процессах получения тонкопленочных материалов: лаб. практикум	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2013
Л3.5	Рабинович О. И., Крутогин Д. Г., Маренкин С. Ф., Подгорная С. В.	Основы технологии электронной компонентной базы: учебно-метод. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2015
	=	। ень ресурсов информационно-		и «Интернет»
Э1		уктур" в LMS CANVAS	https://lms.misis.ru/enroll/TRW	TH6
Э2	ЭБС "Лань"		https://e.lanbook.com	
	База статей Scopus			

	6.3 Перечень программного обеспечения					
П.1	Win Pro 10 32-bit/64-bit					
П.2	ANSYS Academic Research CFD					
П.3	Microsoft Office					
П.4	LMS Canvas					
П.5	MATCAD					
	6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных					
И.1	Научные журналы и статьи					
И.2	http://elibrary.ru/					
И.3	https://link.springer.com/					
И.4	Web of Science https://apps.webofknowledge.com					
И.5	Scopus https://www.scopus.com/					
И.6	Elsevier https://www.sciencedirect.com/					

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Ауд.	Назначение	Оснащение
Читальный зал электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.
Любой корпус Компьютерный класс	Учебная аудитория для проведения практических занятий:	экран, проектор, доска, комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, персональные компьютеры, доступ к ЭИОС университета LMS Canvas, лицензионные программы MS Teams, MS Office
Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина относится к точным наукам и требует значительного объема самостоятельной работы. Отдельные учебные вопросы выносятся на самостоятельную проработку и контролируются посредством текущей аттестации. При этом организуются групповые и индивидуальные консультации. Расчетно-графические работы выполняются с помощью пакета прикладных программ.

Выполнение лабораторных работ связано с использованием электроизмерительных приборов и стендов, являющихся источниками повышенной опасности, так как некоторые элементы их находятся под высоким напряжением. Поэтому к лабораторным работам студенты допускаются только после инструктажа по технике безопасности. Выполнение работ в отсутствии преподавателя запрещается.

Практические занятия проводятся с использованием наглядных пособий, образцов, установок с соответствующим программным обеспечением. Электронные презентации и (или) опорные конспекты теоретических основ дисциплины заранее передаются обучающимся для предварительного ознакомления. Перед проведением практических и лабораторных занятий обучающимся рекомендуется самостоятельно просмотреть теоретический материал по тематике предстоящего занятия. Лабораторные работы проводятся в два этапа: проверка готовности студентов к выполнению работы и проведение всех запланированных экспериментов, защита лабораторных работ.

Образовательная деятельность по дисциплине реализуется с помощью электронной информационно-образовательной среды НИТУ «МИСиС» Canvas, представленной на сайте https://lms.misis.ru/enroll/TRWTH6. В учебном процессе используются программные базы вуза и автоматизированные средства взаимодействия преподавателя и обучающегося. Электронный контент в Canvas содержит все календарные события курса, навигационные ссылки, тесты, задания, методические рекомендации и электронные материалы.